性能特点

- 频率范围：DC–40 GHz
- 可选固定衰减量：0、1、2、3、4、5、6、7 dB
- 耐受功率：+27 dBm
- 输入/输出阻抗 : 50 Ω
- 芯片尺寸：0.55*0.65*0.1mm
- 100%在片测试

产品介绍

LXA61系列化单片集成固定衰减器芯片（Die)提供了8种固定衰减量：0、1、2、3、4、5、6、7dB，在DC～40GHz的频率范围内具有优良的衰减平坦度和端口驻波特性，适用于微波混合电路和多芯片模块。芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证了良好的接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶焊接或导电胶粘接工艺。

电气性能参数 （TA = +25℃）

型号	频率范围GHz	衰减量dB	衰减平坦度dB	S11/S22
	GHz	dB	dB	dB min
LXA6190	DC–40	0	± 0.2	20/20
LXA6191		1	± 0.2	23/23
LXA6192		2	± 0.2	24/24
LXA6193		3	± 0.2	27/27
LXA6194		4	± 0.2	22/22
LXA6195		5	± 0.2	25/25
LXA6196		6	± 0.2	23/23
LXA6197		7	± 0.2	20/20

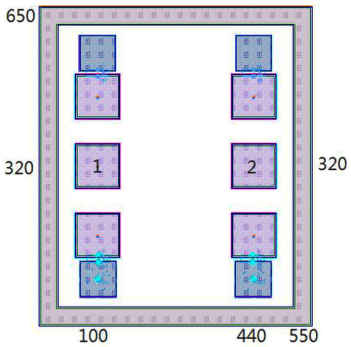
使用限制参数

项目	数值
最高输入功率	+27 dBm
工作温度	–55 ～ +85 ℃
储存温度	–65 ～ +150 ℃

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

键合点定义



管脚	名称	描述
1	RF 01	RF端口，阻抗50Ω，直流耦合不需外接隔直电容
2	RF 02	RF端口，阻抗50Ω，直流耦合不需外接隔直电容
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好

说明

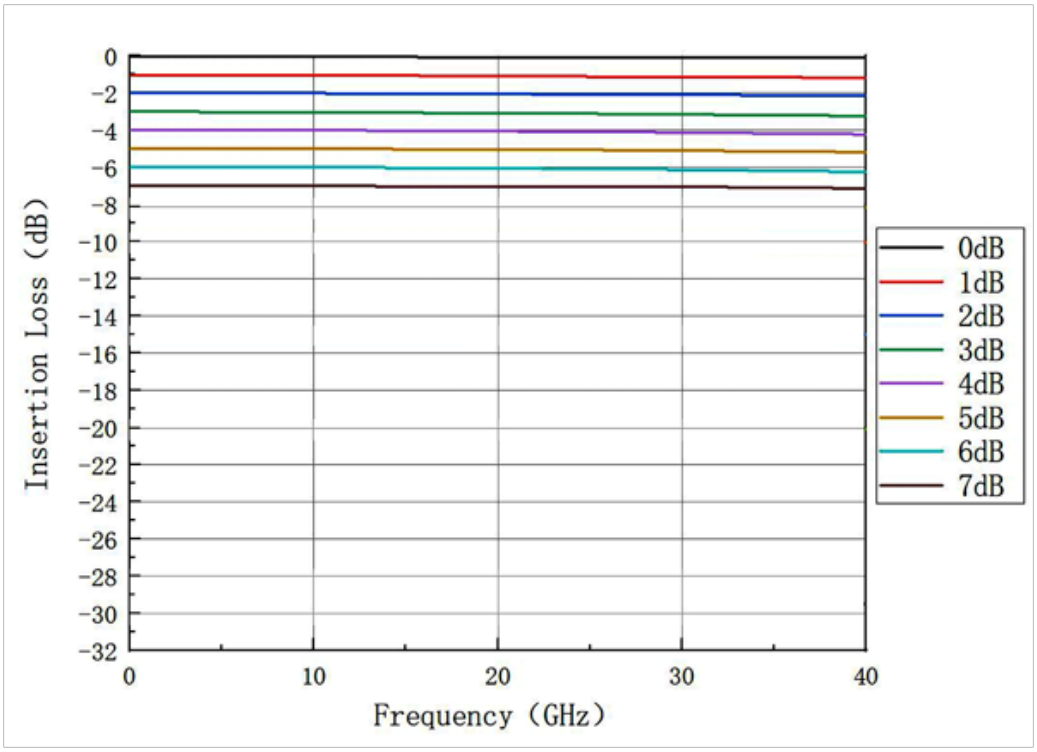
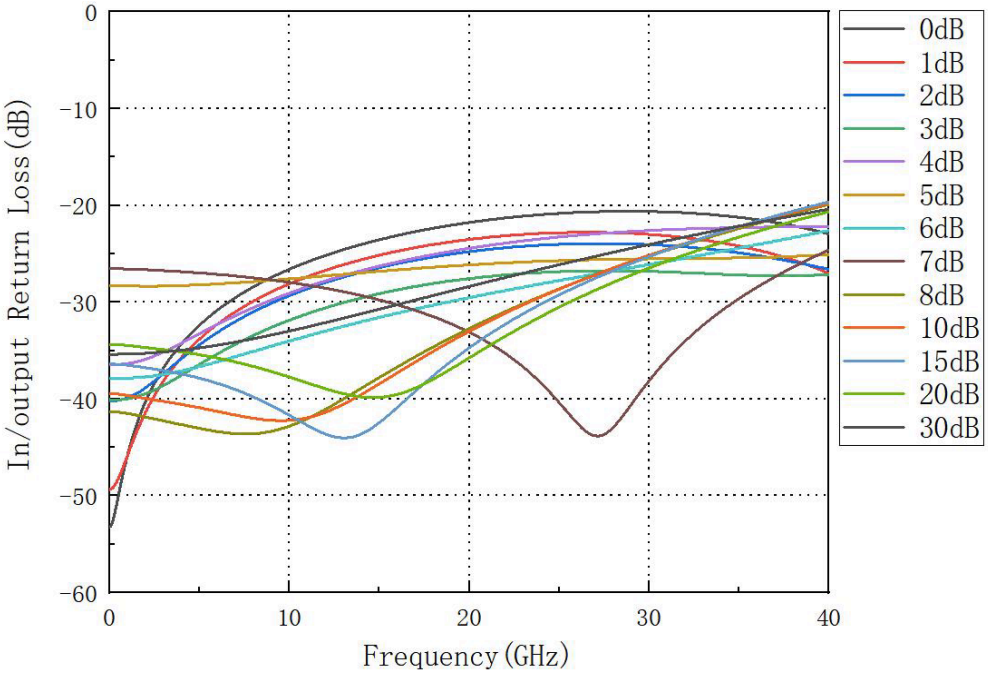
1. 单位：μm
2. 键合压点尺寸：100X120μm
3. 芯片背面镀金接地
4. 外形尺寸公差：±50μm

装配说明：

1. 芯片厚度100um。
2. 在净化环境装配使用，不要碰触表面，以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合（直径25um），键合线尽量短，不要长于400um。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结，温度不要超过300℃，烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

典型测试曲线

损耗 VS 频率



输入/输出回波 VS 频率